

薄型インバーター

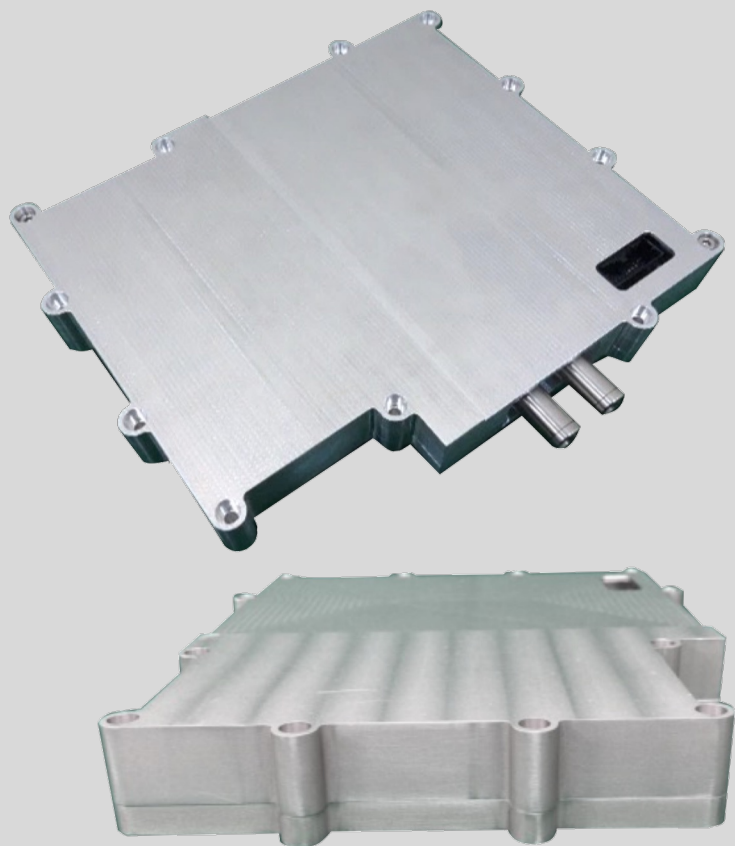
Thin-type Inverter

✓ パワー半導体をプリント配線基板に一体化して実装する基盤技術を開発

We have developed a packaging technology to integrate power semiconductor device into printed-wiring assembly.

試作サンプル

Prototype sample



適用先

Applications

- **xEV向け駆動用インバーター**
Traction inverter for xEV(BEV,PHV)
- **電力変換器**
Power converter

主な仕様

Specifications

Volume	1.5 L
Max Output	170 kVA
Max Current	350 Arms
Power density	113 kVA/ℓ